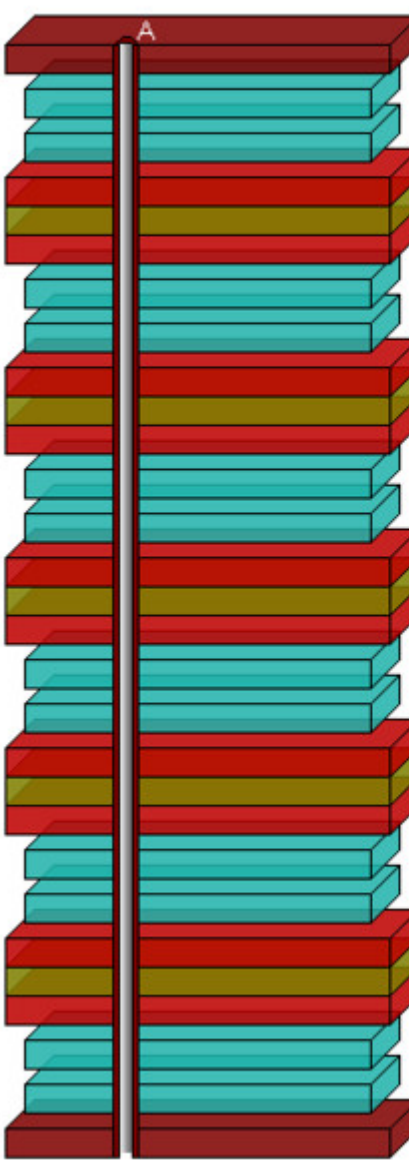


Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		Cu+galv.Cu		18+25	
		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
2		Cu		35	
		Tr-Lam	0.25		
3		Cu		35	
		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
4		Cu		35	
		Tr-Lam	0.25		
5		Cu		35	
		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
6		Cu		35	
		Tr-Lam	0.25		
7		Cu		35	
		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
8		Cu		35	
		Tr-Lam	0.25		
9		Cu		35	
		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
10		Cu		35	
		Tr-Lam	0.25		
11		Cu		35	
		Prepreg	0.068		1080
		Prepreg	0.068		1080
12		Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke * 2,38 +/- 10%

Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske * 2,49 +/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 300 µm
	Viapad-Ø	≥ 600 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Standard	
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm ≥ 120 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm ≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm ≥ 240 µm
	Leiterbild Innenlagen	
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm ≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm ≥ 100 µm